

Singulation System

Model FMS3040



Ring offload type

Singulation system for cutting various packages

多様なパッケージの個片化を実現する シンギュレーション装置

製品情報



日本語

- オフロード製品処理方法のバリエーションを充実
- ワークサイズ100×300mm対応
- 最小1.0×1.0mmサイズの製品を切断可能
- UPH40,000を高速搬送にて実現



Bulk type



Tray type

SPECIFICATION

Items		Unit	Description					
モデル		—	FMS3040					
装置区分		—	Bulk type		Tray type		Ring offload type	
ワークサイズ	長さ	mm	150—300					
	幅	mm	40—100					
	厚み	mm	0.5—2.0					
パッケージサイズ	最小	mm	1×1					
	最大	mm	25×25					
基板反り量		—	3mm／300mm (Max.)					
ダイサー		—	Twin spindles, Twin tables					
外形寸法	モジュール	module	Cut Engine	Offload	Cut Engine	Offload	Cut Engine	Offload
	幅	mm	1,960	325	1,960	1,500	1,960	2,290
	奥行き	mm	1,760	720	1,760	1,760	1,760	1,760
	高さ	mm	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	2,070
重量		ton	3.1		4.9		5.4	
ワーク供給部	タイプ	—	スリットマガジン					
	数量	pcs	4 (Max.)マガジン幅115mmの場合					
製品収納部	タイプ	—	Bulk box		JEDEC Tray		12" ring magazine	
	数量	pcs	—		50 (Max.)		1—2	
ピック&プレイスヘッド数		—	—		2units×7pcs or 2units×11pcs			
キット交換時間		min	10					
製品搬送方式		—	Vacuum					
製品処理能力		UPH	40,000 (Max.)				30,000 (Max.)	

- ・上記数値は当社標準機の場合です。
- ・改良のため仕様を変更する事があります。
- ・特殊システム仕様についてはご相談ください。

TOWA株式会社

本社

〒601-8105

京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地

お問い合わせ先



TOWA (当社のハウスマーク)、 はTOWA株式会社の商標または登録商標です。

海外販売拠点

中国
TOWA (Shanghai) Co., Ltd.

台湾
TOWA Taiwan Co., Ltd.

韓国
TOWA Korea Co., Ltd.

シンガポール
TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

マレーシア
TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

タイ
TOWA THAI COMPANY LIMITED

フィリピン
TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.

インド
TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED

ドイツ
TOWA Europe GmbH

オランダ
TOWA Europe B.V.

アメリカ
TOWA USA Corporation

20250401-005-HQ